

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COGOBUY GROUP

科通芯城集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：400)

本集團於2018年第二季度的未經審核營運概要

本公佈載列科通芯城集團(「科通芯城」或「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)截至2018年6月30日止三個月的未經審核營運概要，乃基於未經我們的外部核數師審核或審閱的本集團內部數字及本公司管理賬目而作出。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的規定而作出。

科通芯城集團欣然宣佈，本公司戰略調整完畢。本公司IC元器件直接銷售業務於第二季度持續恢復成長，加之硬蛋平台(「硬蛋」)升級人工智能(「AI」)物聯網(「物聯網」)，統稱「AIoT」企業服務平台帶來額外服務收益，本集團於2018年第二季度錄得收入達人民幣1,544.2百萬元，按非公認會計原則計量權益股東應佔溢利¹約為人民幣117.5百萬元。

本公司在去年第四季正式確立「硬蛋AIoT企業服務平台+IC元器件交易平台雙引擎」發展模式，以IC和AIoT為主營方向，捕捉新興電子製造的機遇。硬蛋AIoT企業服務平台主要有三大盈利策略，(i)為芯片銷售導流；(ii)開發及銷售本集團之專利AI硬件模塊；及(iii)獲取AIoT科技成果產業化收益。於本公告日期，硬蛋AIoT生態系統的企業數目已突破3.8萬家，包括AI算法公司、底層芯片公司、模塊公司、技術方案提供商及具備龐大採購需求的物聯網項目，覆蓋智能汽車、智能家居、機器人、AIoT定制芯片等領域。

1 權益股東應佔純利加以股份為基礎的補償成本、無形資產攤銷及其相關遞延稅項影響。

業務摘要

- 今年4月，硬蛋實驗室旗下的K系統成功在全志科技R16芯片技術上，開發具備自身專利技術的SLAM掃地機器人AI模塊，並正式進入量產化階段；本集團持續與全志合作優化SLAM演算法技術，以擴大技術優勢。另一邊廂，硬蛋平台上的戰略合作夥伴一雲知聲成功通過硬蛋平台把AI芯片做成模組，發佈全球首款面向物聯網技術的人工智能芯片，足證科通芯城在助力推廣中國芯的實力。
- 有見中美貿易戰愈演愈烈，本集團積極與美國以外的領先芯片製造商建立合作關係。今年5月，本集團與歐洲最大的微電子研究中心簽訂協議，在深圳共同打造硬蛋微電子創新中心，銳意打造世界超一流從芯片設計、製造到應用的全產業平台。該中心目前在傳感技術、傳感器網絡、通信、超低功耗技術、超低頻無線電等方向，積累了大量向AIoT企業提供定制芯片的成功案例。
- 2018年6月，本集團訂立協議收購株式會社GIPP之40%股權——一家承辦十餘家包括索尼及豐田等日本一線科技企業約10萬項專利的海外管理與營運的日本企業，並會利用硬蛋平台資源提供事業開發諮詢，為硬蛋平台的產業鏈引進很多國際化的產業資源，把眾多日本企業的核心技術引入中國。
- 2018年上半年，本集團從減持EZ Robot, Inc.獲取人民幣181.8百萬元的收益，這個硬蛋平台所孵化的易造機器人項目(「易造項目」)成為硬蛋產業業化的首個成功案例。

前景

本集團通過硬蛋平台對物聯網、人工智能及芯片企業的支持，逐步從硬件營銷及銷售平台，升級轉型至企業服務平台，未來我們將致力為更多AIoT企業提供多維度服務，其中包括AI解決方案、供應鏈管理和芯片IP核設計等。隨著物聯網、大數據和雲計算等技術落地方興未艾，信息技術與工業製造的深度融合，市場對芯片、AI模塊的需求將迎來歷史峰值，科通芯城作為領先的IC元器件的分銷商及定制芯片的供應商，將扮演愈來愈重要的角色。我們尤其著重於新興領域芯片企業合作關係，加強IC元器件銷售務和硬蛋服務的協同效應。同時，芯片行業將會形成眾多零散需求，芯片應用場景的多元化促使眾多『小市場』應運而生，企業服務平台的核心競爭優勢將愈發明顯。

根據中國半導體行業協會發布數據顯示，2017年中國半導體的進口額為2,601億美元。目前全球百大芯片製造商當中，超過一半是本公司的合作供應商。本集團相信，隨著芯片國產替代的推進，大量中國芯片製造商有望通過規模效應擴大市場佔有率，而本公司已經與國內36家領先芯片製造商建立長期合作關係，涵蓋了國內絕大部分大型芯片製造商。憑著精準的產業鏈資源，有望助力『中國芯』產業鏈實現跨越式的發展，即使在中美貿易戰的背景，本集團的芯片業務會繼續保持成長。

本公司相信，新發展策略將降低集團對外部資金的依賴，有效避免銀行信貸恢復速度較慢對集團帶來的潛在經營風險。展望下半年，本公司會繼續依賴自有資金，推動硬蛋平台產業化，並致力以質取勝，為未來利潤的可持續增長打下穩固基礎。在區塊鏈硬件以及5G需求的帶動下，預期下半年的本集團的IC芯片銷售將較上半年進一步增長。而硬蛋方面，易造項目以外，硬蛋的新項目，如定制芯片、區塊鏈硬件，智能汽車等，預期會在2019年逐步落地，為本集團提供持續動力。

前瞻性聲明

除了與本公司相關的事實聲明外，本公佈載列的若干信息構成前瞻性聲明。前瞻性聲明經常使用「計劃」、「預期」、「推算」、「有意」、「相信」、「預計」等詞彙及其它類似用詞或聲明，來表達若干事件或情況「可能會」或「將會」發生。前瞻性聲明乃根據管理層於作出有關聲明當日的意見及估計作出，涉及多種風險及受多種不確定因素及其它因素所規限，或會導致實際事件或結果與前瞻性聲明所預測者出現重大差異。此等因素包括本公司取自行內的歷史參考資料、往績記錄、於2018年第二季度的收益、預期充足的流動資金及資本資源以履行持續責任及未來合約承擔；能否推行企業發展策略；及並無過往實例的其他聲明。除法律規定者外，本公司並無責任按情況或管理層估計或意見的變動而對前瞻性聲明進行更新。因此，謹請讀者切勿過度依賴前瞻性聲明。

承董事會命
科通芯城集團
主席兼執行董事
康敬偉

香港，2018年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為康敬偉先生、胡麟祥先生及倪虹女士；及本公司獨立非執行董事為葉忻先生、馬啟元博士及郝純一先生。